|  |  |
| --- | --- |
|  | **国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)****涵盖电子元器件、组装件、相关物料和过程****IECQ有关规则及详情，请访问 www.iecq.org** |

|  |
| --- |
| **IECQ 符合性证书****有害物质过程管理** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IECQ 证书号码:** | **IECQ-H POSI 20.0013** | **发出序号:** | **1** | **状态:** | **Current** |
| **取代**: |  | **发行日期:** | **2020/08/07** | **原发出日期:** | **2020/08/07** |
| **认证机构文件号码:** | 202006033QC | **失效日期:** | **2023/08/06** |  |  |

|  |
| --- |
| 适用于: |
| * **European Directive 2011/65/EU (“RoHS – Restriction of the use Of certain Hazardous Substances”) in electrical and electronic equipment. Including all published amendments**
* **Customer specified requirements**
 |

|  |
| --- |
| **四川遂宁市利普芯微电子有限公司**四川省遂宁市经济技术开发区飞龙路66号 |

|  |
| --- |
| 该组织已制定和实施有害物质过程管理程序和相关过程，经审核，发现这些程序及过程符合适用的IECQ HSPM组织批准要求，即IEC电子元器件质量评定体系（IECQ）的基本规则IECQ 01和程序规则IECQ 03-5 “IECQ 有害物质过程管理”，以及IECQ规范：* IECQ QC080000: 2017 - 有害物质过程管理体系要求
 |

|  |
| --- |
| **此证书适用于以下活动范围內的所有电子元器件、组裝件、相关物料和过程：**  |
| **集成电路（贴片式小型化半导体封装、直插式半导体封装）的生产和销售**-- Attached Schedule(s):- Non -- |

|  |
| --- |
| **由认证机构签发: Shanghai POSI Certification Co. Ltd.** |
| Rm. 1002-A, No.1500 Century Avenue,Shanghai Free Trade Zone, 200122China获授权人: **Ivy WANG** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\86159\Desktop\下载.png | 本证书效力由颁发此证的IECQ CB进行连续监督审核来予以维持。本证书可根据IECQ体系及其方案的程序规则予以暫停或撤销。本证书及任何附件只可完整复制。此证书不可转让及为IECQ CB的财产。可访问www.iecq.org验证此证书的状态及真实性。 |  |
|  |